

中信建投证券股份有限公司
关于恒玄科技（上海）股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称： 恒玄科技（上海）股份有限公司
保荐代表人姓名：董军峰	联系方式：021-68801585 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：贾兴华	联系方式：021-68801554 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

2020 年 12 月 16 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”、“公司”）在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为恒玄科技的保荐机构，对恒玄科技进行持续督导，持续督导期为 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年度，中信建投证券对恒玄科技的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交	本持续督导期间，公司未发生按有关规定需公开发表声明的违法违规事项。

序号	工作内容	持续督导情况
	易所审核后在指定媒体上公告。	
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	本持续督导期间，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期间，保荐机构已督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	本持续督导期间，保荐机构已督导公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	本持续督导期间，保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	本持续督导期间，保荐机构已督导公司严格执行信息披露制度，并审阅其向上海证券交易所提交的信息披露文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会	本持续督导期间，恒玄科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

序号	工作内容	持续督导情况
	会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了具体的检查工作要求。本持续督导期间，公司未出现该等需开展专项现场检查的事项。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	本持续督导期间，公司不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、因技术升级导致的产品迭代风险

集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快，持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段。公司产品从导入客户到大批量出货，通常需要 1 年左右时间，并可保持平均约 3 年的销售期。若公司无法保持较快的技术更迭周期，并持续推出具有竞争力的新产品以满足市场新需求，则将无法维持新老产品的滚动轮替及收入的持续增长，并对经营业绩带来不利影响。

2、研发失败风险

公司的主营业务为智能音视频 SoC 芯片的研发、设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，对下一代芯片进行产品定义，并在研发过程中持续投入大量资金和人员。由于技术的产品化和市场化始终具有一定的不确定性，未来如果公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。

3、核心技术泄密风险

通过持续技术创新，公司自主研发了一系列核心技术，这些核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。当前公司多项产品处于研发阶段，核心技术保密对公司的发展尤为重要。如果公司在经营过程中因核心技术信息保管不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力产生不利影响。

4、核心技术人才流失风险

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，对于研发人员尤其是核心技术人才的依赖远高于其他行业。公司已针对优秀人才实施了股权激励等相应的激励措施，对稳定公司核心技术团队起到了积极作用。但随着行业规模的不断增长，集成电路设计企业对于核心技术人才的竞争日趋激烈，如果公司不能持续加强对原有核心技术人才的激励和新人才的引进，则存在核心技术人才流失的风险，将对公司新产品的持续研发能力造成不利影响。

(二) 经营风险

1、产品终端应用形态相对单一的风险

公司主营业务为智能音视频 SoC 芯片的研发、设计与销售，芯片目前主要应用于智能可穿戴和智能家居类低功耗智能音视频终端，包括 TWS 耳机、智能手表、智能音箱等。报告期内，公司应用于智能可穿戴产品的芯片销售收入占比较高，而在其他市场形成的收入规模占营业收入的比例相对较小，产品终端应用形态呈现相对单一的特征。

公司虽然已在其他市场进行产品布局和市场开拓，但如果相关研发进度不及预期，或公司未能顺利在非可穿戴市场进行业务拓展，或公司无法在可穿戴市场持续占据优势地位，一旦市场出现波动，将会对公司经营业绩带来不利影响。

2、委托加工生产和供应商集中风险

公司采取 Fabless 的运营模式，仅从事集成电路产品的研发、设计、销售业务，将芯片制造及封装测试工序外包。晶圆制造、封装、测试为集成电路生产的重要环节，对公司供应商管理能力提出了较高要求。尽管公司各外包环节的供应商均为知名的晶圆制造厂及封装测试厂，其内部有较严格的质量控制标准，公司也制定了详细的供应商管理制度，并对供应商质量进行严密监控，但仍存在某一环节出现质量问题进而影响最终芯片产品可靠性与稳定性的可能。

基于行业特点，全球范围内符合公司技术要求、供货量和代工成本的晶圆和封装测试供应商数量较少。公司向现有供应商支付的晶圆采购及封测服务费合计占当期采购总额的比重仍然较高。随着行业中供求关系变化和晶圆/封装测试供

应商的产线升级等，或带来公司采购单价的变动，若委托加工生产的采购单价上升，会对公司的毛利造成不利影响。此外，如果现有晶圆及封测供应商的工厂发生重大自然灾害等突发事件，或者由于晶圆供货短缺、外协厂商产能不足或者生产管理水平欠佳等原因影响公司产品的正常生产和交付进度，则将对公司产品的出货和销售造成不利影响，进而影响公司的经营业绩和盈利能力。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

虽然公司现阶段应收账款账龄结构良好、发生坏账损失的风险较小，但随着公司经营规模的持续扩大、或者受市场环境和客户经营情况变动等因素影响放宽信用政策，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

2、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品、发出商品构成。存货规模随业务规模扩大而逐年上升。若市场需求环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售和采购、以美元报价和结算的情况。随着公司总体业务规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，虽然公司在业务开展时已考虑了合同或订单订立及款项收付之间汇率可能产生的波动，但随着国内外政治、经济环境的变化，汇率变动仍存在较大的不确定性，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

4、税收优惠政策变动风险

公司于 2022 年度通过高新技术企业认证复审，并取得编号为 GR202231004394 的《高新技术企业证书》，有效期自 2022 年起 3 年，在有效期内可享受企业所得税税率为 15% 的税收优惠政策。如果未来国家上述税收优惠政

策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则公司可能面临因税收优惠变动或减少，从而降低未来盈利的风险。

5、毛利率波动风险

公司产品主要应用于智能可穿戴和智能家居领域，具有市场竞争较为激烈、产品和技术更迭较快的特点。未来如果行业竞争加剧或公司无法通过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品毛利率下降，将对公司的业绩产生较大影响。

（四）行业风险

智能音视频 SoC 芯片市场的快速发展以及技术和产业链的成熟，吸引了越来越多芯片厂商进入并研发相关产品。公司面临国际大厂的竞争，其在整体资产规模、产品线布局上与公司相比有着显著优势。公司产品目前主要应用于智能可穿戴和智能家居等消费电子领域，终端品牌客户的市场集中度较高。公司如未能将现有的市场地位和核心技术转化为更多的市场份额，则会在维持和开发品牌客户过程中面临更为激烈的竞争，存在市场竞争加剧、一些大厂利用其规模、产品线和客户等优势挤压公司市场份额的风险。

（五）宏观环境风险

公司所处行业为技术密集型、资金密集型行业，受到国内外宏观经济、行业法规和贸易政策等宏观环境因素的影响。近年来，国家出台了相关的政策法规大力支持半导体行业发展，公司业务发展稳定。近年来，伴随全球产业格局的深度调整，已有部分国家通过科技和贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了不利影响。未来，如果国内外宏观环境因素继续发生不利变化，如重大突发公共卫生事件引起全球经济下滑、中美科技和贸易摩擦进一步升级加剧等，将会影响半导体材料供应和下游电子消费品需求下降，从而影响公司的产品销售，对公司经营带来不利影响。

（六）法律风险

1、知识产权风险

芯片设计属于技术密集型行业，该行业知识产权众多。在产品开发过程中，

涉及到较多专利权、集成电路布图设计专有权及计算机软件著作权等知识产权的授权与许可，因此公司出于长期发展的战略考虑，一直坚持自主创新的研发战略，做好自身的知识产权的申报和保护，并根据需要取得第三方知识产权授权或购买第三方知识产权，避免侵犯他人知识产权。但未来不排除竞争对手或第三方采取恶意诉讼的策略，阻滞公司市场拓展的可能性，也不排除公司与竞争对手或第三方产生其他知识产权纠纷的可能。公司在境外注册部分知识产权，但不同国别、不同的法律体系对知识产权的权利范围的解释和认定存在差异，若未能深刻理解往往会引发争议甚至诉讼，并随之影响业务经营。

此外，产业链上下游供应商与客户的经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

2、技术授权风险

公司研发过程中需要获取相关 EDA 工具和 IP 供应商的技术授权。EDA 工具和 IP 供应商集中度较高，主要系受集成电路行业中 EDA 工具和 IP 市场寡头竞争格局的影响。虽然公司与相关供应商保持了良好合作，但如果国际政治经济局势、知识产权保护等发生意外或不可抗力因素，EDA 工具和 IP 供应商不对公司进行技术授权，则将对公司的经营产生不利影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年，公司主要财务数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,176,277,305.68	1,484,798,365.59	46.57
归属于上市公司股东的净利润	123,625,456.63	122,419,406.98	0.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,612,304.79	12,126,107.71	135.96
经营活动产生的现金流	469,733,582.19	-360,022,777.67	不适用

量净额			
主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,097,172,082.74	5,962,764,278.87	2.25
总资产	6,551,376,442.37	6,413,264,617.13	2.15

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	1.0339	1.0211	1.25
稀释每股收益（元/股）	1.0239	1.0177	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2393	0.1011	136.70
加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.06	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47	0.20	增加0.27个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	25.27	29.62	减少4.35个百分点

2023年，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

报告期内受益于全球经济复苏，消费市场逐步回暖，公司下游客户对芯片需求量增加。同时公司基于 12nm FinFET 工艺研发的新一代 BES2700 系列可穿戴主控芯片广泛应用于 TWS 耳机、智能手表等终端产品，使得公司实现营业收入 21.76 亿元，同比增长 46.57%。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，扣除非经常性损益的净利润 0.29 亿元，同比分别增长 0.99% 和 135.96%，主要系①为保持公司长期竞争力，报告期内公司持续投入研发，研发费用同比增加 1.10 亿元；②上游成本上涨，同时消费电子产品单价下降，使得公司毛利率下降，全年综合毛利率 34.20%，同比下降 5.17 个百分点。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入 4.70 亿元，主要系报告期内公司营收规模增长，销售回款同比大幅增加，同时持续推进去库存化，购买商品支付的现金同比减少，使得经营活动现金流量净额由负转正。

六、核心竞争力的变化情况

（一）前瞻的技术规划和产品定义能力

公司研发团队具有丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，把握住了智能可穿戴市场的成长机遇。在 TWS 耳机领域，公司以前瞻的产品定义及快速的响应能力，较早推出支持双耳通话、集成主动降噪等功能的领先产品，迅速抢占了品牌市场。在智能手表领域，公司通过在蓝牙、低功耗、高集成等方向多年的技术积累，成功推出了业内第一颗运动手表单芯片主控，已导入多家品牌客户手表方案。为了满足客户不断提升的性能需求，公司在业内率先推出采用 12nm 和 6nm 先进工艺的新一代可穿戴主控芯片，公司始终保持产品定义的领先，从而满足品牌客户对产品持续升级的诉求，与品牌客户的深入合作又进一步强化了公司产品定义的前瞻性。

（二）领先的技术优势

公司持续在研发上大力投入，技术能力是公司的核心和基石。报告期内，公司在多项核心技术上取得进步并保持行业领先，包括：

①多核异构 SoC 技术。公司新一代智能可穿戴主控芯片在单芯片上集成了多核 CPU、音频 DSP、应用于图像图形转换加速的 2.5D GPU、可穿戴低功耗显示系统控制器和神经网络加速的协处理器，极大的提升了数字信号处理和机器学习的能力。

②双频低功耗 Wi-Fi 技术。公司 Wi-Fi6 连接芯片已实现量产，该芯片将射频大功率放大器（PA），低噪声放大器（LNA）和收发切换开关（Switch）进行了全集成，并具备低功耗、低延时等优势。

③支持 BT5.4 的蓝牙技术。公司新一代智能可穿戴芯片全面支持 BT/BLE 双模 5.4 协议，在 IBRT 技术的基础上，开发出了支持一拖二和多点连接的新一代 IBRT 解决方案，极大方便了蓝牙 TWS 产品与不同设备音频之间的无缝切换。

④先进的声学系统。公司在声学领域不断精进，自适应 ANC、通话降噪、关键字识别等技术行业领先，并在 PSAP 辅助声学增强、动态低音、虚拟低音、空间音频等领域，都研发出了具有竞争力的解决方案。

⑤智能手表平台解决方案技术。公司基于自身平台开发了一套完整的智能手表软件解决方案，包括蓝牙音乐/语音通话，流畅的表盘显示技术，传感器和手机之间稳定的数据交互能力等。

⑥可穿戴平台智能检测和健康监测技术。公司除了将射频、音频、电源管理等模拟接口集成外，还进一步在 TWS 耳机主控芯片上集成了高精度的电容传感器和 8 路全集成佩戴检测，可配合耳机完成各种手势操作，并基于可穿戴平台进一步自主研发基于光学的心率、血氧等健康监测前端。

⑦先进工艺下全集成射频技术。公司新一代智能可穿戴芯片集成了射频、音频、电源管理等模拟电路，以及多核处理器、蓝牙基带和丰富接口。自主研发的蓝牙射频收发系统，在先进工艺下集成了大功率放大器，低噪声放大器和片上的开关电路及各种无源电感电容器件，同时电源电压更低，进一步降低了功耗。

⑧全集成音视频存储高速接口技术。公司第二代集成 ARM Cortex-A 系列 CPU 的 Wi-Fi SoC 芯片 BES2600 系列，集成 DSI 显示接口、CSI 摄像头接口，以及高速并行接口 DDR 控制器和 PHY 技术，并率先支持鸿蒙系列操作系统。公司在 AIoT 和可穿戴平台顺应客户趋势，向高速、大带宽、大算力演化，自研高速并行和串行接口技术也得到不断提升。

（三）高研发投入，构建知识产权壁垒

公司积极投入研发，为产品持续保持领先优势打下基础。公司围绕无线连接、降噪、智能语音等方面已经构建核心技术及知识产权体系，通过持续的技术创新和技术积累，树立了知识产权壁垒。截至报告期末，发行人及其子公司合法拥有 225 项专利，其中包括 195 项发明专利和 23 项实用新型专利。公司高度重视研发人才的培养，截至 2023 年末，公司共有技术人员 592 人，占全部员工人数的比重达 85.80%。

（四）深耕品牌客户，树立了较高的商业门槛

经过持续的产品技术迭代及市场验证，公司已覆盖全球主流安卓手机品牌、专业音频厂商、互联网公司以及家电厂商等终端客户。公司产品作为智能终端设备的核心芯片，直接关系到最终产品的性能和用户体验。品牌客户在选择芯片供

应商时极为严格谨慎，进入门槛较高，需经过长期产品审核和验证才能进入其供应体系。终端品牌厂商在新产品研发过程中，与芯片厂商高度配合、协同研发，因此在长期合作中形成了较强的黏性。同时，进入品牌客户的供应体系后，产品成功的应用经验又可以形成良性循环，进一步扩展公司的品牌客户范围。主流终端品牌厂商综合实力强，同时不懈追求技术创新，代表了行业的发展方向。公司伴随品牌厂商发展，可以持续保持产品的领先性。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化情况

2023年，公司研发支出变化情况如下：

单位：元

项目	2023年	2022年	变化幅度（%）
费用化研发投入	549,919,033.94	439,780,877.40	25.04
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	549,919,033.94	439,780,877.40	25.04
研发投入总额占营业收入比例（%）	25.27	29.62	减少 4.35 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

公司 2023 年末研发人员达 592 人，较上期末增长 71 人，研发费用同比增长 11,013.82 万元，增幅 25.04%。其中，研发人员薪酬及股份支付费用和长期资产折旧及摊销分别同比增长 8,076.57 万元和 3,322.96 万元。

（二）研发进展情况

报告期内，公司持续加大在各产品领域的研发投入，新一代 6nm 智能可穿戴芯片 BES2800 成功流片，公司产品竞争力稳步提升。报告期内，公司新增申请发明专利 115 项，获得发明专利批准 52 项；截至 2023 年末，公司累计申请发明专利 488 项，累计获得发明专利批准 195 项。具体情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	115	52	488	195
实用新型专利	10	5	29	23
外观设计专利	0	0	1	1

软件著作权	0	0	1	1
其他	0	0	5	5
合计	125	57	524	225

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	4,862,100,000.00
减：以前年度使用募集资金余额	4,252,442,002.92
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	609,657,997.08
加：2023 年度专户利息收入	9,367,676.39
2023 年度专户理财收益	51,474,308.27
理财产品到期赎回	6,056,000,000.00
可转让大额存单转让	60,000,000.00
减：购买理财产品	5,434,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金	3,776,310.39
转至回购证券专户的募集资金	24,998,668.27
募投项目本年支出	559,899,056.67
手续费支出	9,982.14
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	763,815,964.27

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人为 Liang Zhang、赵国光和汤晓冬；2023 年度，恒玄科技的控股股东及实际控制人均未发生变化。

截至 2023 年 12 月 31 日，恒玄科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股数量（股）
Liang Zhang	控股股东、实际控制人，董事长	4,943,052
赵国光	控股股东、实际控制人，副董事长、总经理	12,162,876
汤晓冬	控股股东、实际控制人，董事	13,564,784
Xiaojun Li (已离职)	董事	0
刘越	董事	0
李广平	董事、财务总监、董事会秘书	0
王志华	独立董事	0
戴继雄	独立董事	0
王艳辉	独立董事	0
黄律拯	监事会主席	0
项斌	监事	0
俞淼	监事	1,271

截至 2023 年 12 月 31 日，恒玄科技的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的恒玄科技股份均不存在质押、冻结及减持情形。

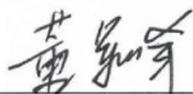
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

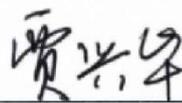
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



董军峰



贾兴华

中信建投证券股份有限公司



2024年3月28日

1100000047469